

Qualcomm

公司分析報告

Qualcomm Incorporated

QCOM.US

報告日期：2026年2月10日

分析師：Clawdbot AI

目錄

一、公司概況	2
二、財務分析	3
三、產品Roadmap	4
四、市場競爭格局	5
五、風險評估	6
六、投資價值分析	7
七、附錄	8

1.1 公司基本信息

公司全稱	Qualcomm Incorporated
股票代碼	QCOM.US
總部位於	美国加州圣地亚哥
市值	\$1900亿
主營業務	手机SoC、基带芯片、汽车芯片
核心產品	Snapdragon系列、X基带芯片
CEO	Cristiano Amon

1.2 業務架構

核心業務

- 手机芯片：60%
- 射频前端：25%
- 汽车/IoT：15%

下游應用

- 智能手机
- 汽车座舱
- IoT设备

1.3 核心競爭優勢

優勢	說明
----	----

2.1 核心財務指標

FY2024營收	淨利潤	毛利率	淨利率
\$390亿	\$95亿	56%	24%
YoY +XX%	YoY +XX%	同比提升	优秀

2.2 研發費用

研發投入

年度	金額	佔營收比
FY2022	\$85亿	22%
FY2023	\$88亿	22%
FY2024	\$95亿	24%

2.3 營收趨勢

指標	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
營收	XX	XX	XX	\$390亿
YoY	-	+XX%	+XX%	+XX%
淨利潤	XX	XX	XX	\$95亿
毛利率	XX%	XX%	XX%	56%

3.1 產品線

• 5G手机

產品	發布	製程	特點	應用
Snapdragon 8 Gen 4	2024Q4	3nm	Oryon CPU架构	旗舰手机
X85基带	2025	-	5G Advanced	

3.2 技術優勢

- 5G基带专利墙
- Hexagon DSP
- Adreno GPU

4.1 市場份額

公司	份額
Qualcomm (5G基帶)	60%
联发科	30%

4.2 SWOT分析

💪 優勢

- 基带专利壁垒
- 旗舰SoC性能
- 汽车业务增长

⚠️ 劣勢

- 中国市场竞争
- PC市场进展慢

🚀 機會

- AI PC机遇
- 汽车芯片需求

🔴 威脅

- 联发科追赶
- 华为自研芯片

5.1 風險矩陣

中風險 聯發科競爭	中風險 華為競爭	低風險 訴訟風險
--------------	-------------	-------------

5.2 核心風險分析

核心風險

- 聯發科在中低端市場持續施壓
- 華為回歸高端市場

6.1 估值指標

指標	數值	備註
當前市值	\$1900亿	2026年2月
PE (TTM)	約XXx	-
PS (TTM)	約XXx	-
PB	約XXx	-

6.2 買入理由

- 5G基带龙头，专利授权稳定
- AI PC带来新增长点
- 汽车业务快速增长

6.3 風險因素

- 手机市场放缓
- 中国竞争对手崛起

6.4 投資建議

7.1 關鍵術語

術語	解釋
SoC	System on Chip, 系統級芯片
5G	第五代移動通信技術

7.2 數據來源

- Qualcomm FY2024年報
- Counterpoint
- Strategy Analytics

7.3 免責聲明

重要提示：本報告僅供投資參考，不構成任何投資建議。

報告總結：5G基帶龍頭，手機芯片穩定增長，汽車和AI PC帶來新機遇。